

SAMPLE LP CH20M22 PPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Optymalne ramy dla funkcjonalności i innowacji:**

Innowacyjna elektronika użytkowa wymaga inteligentnych "opakowań" do perfekcyjnej integracji z otoczeniem systemowym.

Nieustanne prace rozwojowe i konsekwentna rozbudowa palety obudów elektroniki Weidmüller stanowi przyszłościową platformę dla aplikacji elektronicznych w każdej postaci i do wszystkich zadań praktycznych.

Do wszystkich obudów udostępnia się dane CAD płytek drukowanych. Dostępne są złącza śrubowe i sprężynowe.

Konsekwentna synergia designu, techniki złącz i funkcjonalności tworzy optymalną podstawę tworzenia układów elektronicznych, dostosowanych do potrzeb rynku i aplikacji.

Funkcja, forma i zdolności przetwarzania łączą się dla użytkownika w logiczną całość o wysokim stopniu bezpieczeństwa i jakości obsługi.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M , płytka drukowana do samodzielnego wyposażania CH20M22, Szerokość: 22.5 mm
Nr zam.	1105580000
Typ	SAMPLE LP CH20M22 PPX
GTIN (EAN)	4032248880652
Ilość	1 Szt.

SAMPLE LP CH20M22 PPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	24,8 g	Szerokość	22,5 mm
Szerokość (cale)	0,886 inch		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 66 GF 30	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 550
grupa materiałów izolacyjnych	II	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-92
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

SAMPLE LP CH20M22 PPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rysunki**

Layer Stack Up Detail for: 1105580000_03.PcbDoc

Layer	Order	Order	Material	Material	Material
name	Thickness	Thickness	Material	Material	Type
Top Solder Mask	(.015)	0.015mm	Solder Resist		
Top Layer	(.015)	0.015mm	FR-4	Core	
Bottom Layer	(.015)	0.015mm	Solder Resist		
Bottom Solder Mask	(.015)	0.015mm	Solder Resist		
PCB thickness over all 1.6mm +/- 0.13mm					

